

证券代码：688603

证券简称：天承科技

## 广东天承科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参会单位	灏升资产、兴业证券、域秀投资、平安证券、海通研究所、巴沃资管、墨钜资管、华安证券、鹏华基金、浙商证券、正圆基金、东吴基金、长城保险、中泰证券、鲸航资管、东方基金、古曲基金、海富通基金、山西证券、中邮人寿、申万菱信基金、安泽投资、德邦证券、玖鹏资管、远海基金、东方证券、招商电子、太平洋养老保险、瑞信致远基金、致合资管、志开投资、盛宇股权投资、朱雀基金、鹏扬基金、贵源投资、景顺长城基金、进门财经、博时基金、长江证券、中金公司、招商基金、长城证券
调研时间	2024年5月5日（周日）19:00-20:00
会议地点	进门财经
上市公司参会人员姓名	董事长、总经理：童茂军 副总经理、董事会秘书：费维 技术总监：王亚君 财务总监：王晓花 证券事务代表：邹镭骏
投资者关系活动主要内容记录	<p>（一）请问公司能对目前发展近况做个简单介绍吗？</p> <p>答复：</p> <p>纵观 23 年全年至 24 年一季度，公司从业务端整体呈现稳健且持续增长的发展态势，如公司前期所制定的经营策略，不断调整产品结构、持续优化并迭代产品的配方，进而不断提升公司整体的毛利率水</p>

平和核心竞争力，相应成效也体现在了财务数据上面，23 年全年、24 年一季度的毛利率同比都分别增长 4-5 个百分点。营收去年虽然整体有所下降，但是扣除相关原材料持续下行因素后，实际公司业务量在整体上升，包括 24 年一季度，公司整体出货量也有明显的增长，其中电镀类产品的增长更为显著。

在做扎实基本盘的基础上，公司寻求泛半导体领域的第二成长曲线，在原高端 PCB 功能性湿电子化学品基础上，拓宽到集成电路、光伏、面板等赛道，丰富公司的业务发展路线，穿越各个领域产业发展的周期，平滑公司的经营风险，同时也寻求不断突破。

**（二）24 年 Q1 电镀类产品中营收占比最大、增长最快的分别是哪一类产品？24 年 Q1 非流动资产增加与上海二期项目有关吗？二期工程目前进度如何？**

答复：

1) 公司 24 年一季度收入贡献最大的电镀类产品是水平脉冲电镀，增长最快的是 VCP 电镀。2) Q1 非流动资产的增长主要来源于二期项目的投入，集成电路车间的建设需要投入相对较多、价值较高的半导体生产及测试设备。3) 二期项目相关基础建设、设备仪器调试已陆续完成，此外相关政府手续也已完成。目前工厂已具备生产能力，相关质量体系也在按照正常进度推进。

**（三）公司布局半导体领域的原因是什么，公司对于半导体新领域的信心如何？**

答复：

公司以先进封装作为切入点进入集成电路领域，于 23 年下半年开始布局集成电路功能性湿电子化学品相关的核心添加剂产品，集成电路 fab 厂相对于 PCB 工厂的验证周期更长、技术门槛更高。由于集成电路电镀添加剂长期处于被卡脖子的状态，近几年越来越严重。基于公司团队多年沉淀的添加剂研发经验和技術储备，从 1 月份到现在，RDL、bumping、TGV、TSV 等产品均进入到国内头部客户处进行验证，目前都获得了不错的测试结果，符合客户的预期。因此我们相信未来一定会给行业、国家提供可靠的进口替代方案。解

决关键核心技术卡脖子问题，实现核心物料国产供应链自主可控。公司坚持“高端功能性湿电子化学品添加剂”行业领域定位，致力于成为一家极具竞争力的综合型半导体材料上市公司。

**（四）关于 TSV、TGV 电镀铜工艺有何区别，针对此类产品未来有何发展？**

答复：

TSV 在封装领域是指硅基材填孔工艺，TGV 在封装领域是指玻璃基材填孔工艺。

TGV 是目前整个行业新兴的一个热点，公司前期已有相关玻璃基板通孔填孔的研发和技术储备，目前抓住这个时机进行拓展。公司目前与涉及到玻璃硅通孔转接板的下游客户都有接触并测试相关 TGV 产品，反馈的结果较好。从 TGV 来看，公司处于行业第一梯队，与国际公司处在同一水准。

**（五）请问公司对于未来的业绩展望如何？**

答复：

天承一直走的是稳健且前瞻的发展策略，我们的团队深耕电子电路行业近 30 年，是兼备技术沉淀和行业洞察力的优秀团队，相信我们的业绩会是处于持续增长的发展态势。

原因第一是，即便在整体大环境不好的情况之下，我们也依然在结构性的机会中，在行业发展的趋势中通过产品竞争力和持续迭代、开发产品的能力维持一个稳定增长的态势，第二是我们坚持制定的经营策略，立足于技术作为核心竞争力，为行业解决高端产品被外资同行垄断的问题。所以公司抓住了 IC 载板、高端 PCB 的发展机遇。

未来，我们不光通过调整销售结构、优化配方而实现持续增长的盈利能力，还将顺乘高端 PCB、集成电路产业高速发展的趋势。公司同时也会加快国际化布局，目前东南亚的布局上线从今年的第二季度开始会成为公司新的增长点。后续，我们还会持续拓展韩国市场，包括台湾市场。所以整体来说，公司对未来的业绩保持充足的信心。

附件清单

无

日期

2024 年 5 月 8 日

